

～ MECのこれまでとこれから ～

日 時：2021年4月3日（土曜日） 13：00－14：00
出席者：代 表 取 締 役 社 長 前 田 和 夫
コーポレートコミュニケーション室室長 坂 本 佳 宏

MECのコロナ対策について

大きなポイントは2つ。1つ目は、感染拡大防止にどのような対策を打つか。2つ目は、当社は重要なサプライチェーンに組み込まれていて、製品供給を継続するための体制をどう維持していくか。という点に大変苦心した。当社は、本社、研究所、本社工場は人の往来が激しい兵庫県尼崎市にある。密を避けながら、事業活動を継続すべく、働き方は「在宅勤務」「フルフレックス」を推奨し、通勤手段では、当社は通常電車通勤であるが自動車通勤等の手段を利用可能にしたり、そのための補助をする等、また、振替出勤休日を推奨する等柔軟に対応している。出張は自粛する等の対応をとっている。

MECの歴史、半導体の歴史について

当社社名「メック(MEC)」は、「機械(Machinery)」「電子(Electronics)」「化学(Chemistry)」の頭文字からきている。創業からこの社名で、当時は「機械」「電子」「化学」これらを融合させたようなところで、何か新しい物事を生み出そうという考え方でこの社名を付けた。社是は「仕事を楽しむ」。これも創業後間もなく掲げた。当時はこの「仕事を楽しむ」というような社是が非常に珍しかったと聞いている。

次に当社事業にかかわりが強い半導体市場について。半導体は1980年頃に世界で量産が始まり、今日に至るまでいくつか重要な出来事がある。その都度、市場は上がったりと下がったりを繰り返している。当社は、1995年頃からその半導体市場に係っている。当社は、主に電子基板・電子部品製造に使用される薬品を開発、製造、販売している。その薬品は「金属を溶かし、そこに価値を与える」製品である。電子基板の製造はしていないし、「めっき」もしていない。当社は「金属を少し溶かし“取り去る”」ことをやっている。創業は1969（昭和44）年、大阪市ではじまり、1981年から兵庫県尼崎市で生業を立てている。1990年からグローバル展開を始めた。

売上高推移は、半導体市場のそれと似ている。大事な出来事がある時にぐっと伸び、バブル崩壊やITバブル崩壊、リーマンショックの時に沈むといった流れだ。当社主力製品である「CZ」は1995年に発売し、パソコン用パッケージ基板向けの薬品で使用され、当社売上の拡大を牽引している。それ以降は特に半導体後工程に近いところでビジネスをして

いて、主として半導体の成長とともに当社も成長している。最近はスマートフォン向けも増えている。連結通期業績推移は、2019年12月期は半導体不況があり収益が落ちたものの、なだらかな増収増益基調で当期（53期、2021年12月期）に至っている。

MECの技術力について

当社の技術は、金属を溶かし（エッチング）、モノとモノの境界に価値をもたらす技術である。コア技術は4つ。①配線パターンを形成する技術 ②金属表面を粗化し樹脂との密着を物理的に向上させる技術 ③1つの基板上に2種以上の金属が存在する場合、特定の金属だけ取り去る（エッチング）技術 ④金属表面を処理し化学的に密着性を向上する技術、これらが当社のコア技術である。また、当社は研究開発に大変力を入れている「研究開発型企業」である。每期、連結売上高の10%以上を研究開発に投資し、単体人員約1/3を研究開発部門に投入してきている。研究開発が価値を生むということが当社の一番特徴的なところである。製造業であり、製品を生産してお客様にお届けし、アフターサービスも万全にすることが大事。それも日本だけではなくて世界中どこでも同じ品質のサービスを受けていただけるという考え方で事業を展開している。

市場（身の回りのMEC）について

私たちの普段の生活になじみ深いもの、例えば、PC、スマートフォン、タブレット端末、そして直接的なものではないがサーバー等、これら全てに当社技術が使われている。他にもスーパーコンピューターや自動車、遠隔医療、基地局、ロボットそしてウェアラブル等、全てに当社技術が使われている。つまり身の回りにあるものに当社がかかわっているということである。電子基板はその種類によって技術難易度や生産量が違う。当社が強い領域は、技術的難易度が高いパッケージ基板（PKG）やHDI、高多層基板である。これらの基板の製造工程で当社製品が使用されている。PKGは半導体に関わる場所、HDIがスマートフォンにかかる場所が多い。高多層基板はスーパーコンピューター等にかかる場所。多層基板や両面基板は1995年頃まで当社が一生懸命やっていた領域だが、今はシェアが低い。フレキシブル基板は最近技術的要求が高まっていて、当社でもそれに応えるための技術をかなり多く開発し、徐々にお客様に適用していただいている。以前は、フレキシブル基板はシンプルな構造だったが、最近はさまざまなアプリケーションに使われていて、今後当社にとって非常に重要な分野であり続けると考えている。

MECグループネットワークについて

当社の国内外拠点は、国内主工場として、量産品対応の長岡工場（新潟県）、多品種少量対応の尼崎工場（兵庫県）がある。研究所はグループで兵庫県尼崎市に集中させている。開発テーマが多く、2020年には旧研究所を東初島研究所として再開所した。海外拠点は、台湾（営業・生産）、中国珠海（営業・生産）、中国蘇州（営業・生産）、ベルギー（営業・

生産)、タイ（営業・生産）、香港（営業）にある。

これらの子会社をあわせ世界各国の電子基板業者で当社の薬品を使用いただいている。

資本施策（ESG-H）について

ESG に関しては、最近各企業、非常に積極的に取り組まれている。当社では、「環境(E)」は、製品の生産性を向上させる、環境への負荷を下げることを念頭におき企業活動をしている。「社会(S)」は、社会への貢献が一番重要なこと。特に当社のコア事業をとおして社会に貢献する。例えば、5Gへの貢献は社会貢献以外の何ものでもないと思っている。また、ダイバーシティもしっかりと念頭に置きながら経営を進めている。「ガバナンス(G)」は、過半数が社外取締役の取締役会を持っている。そして「ESG委員会」「指名報酬諮問委員会」等を設置している。「ヒューマンリソースイズ(人的資源)の活用」については、当社は研究開発主体であるが、もちろん他の部門がないと研究開発の成果が活かせない。研究開発のアイデアは非常に重要であり、そのために必要なのは人の考え、人のアイデアである。当社は製造業としては、それほど大きな生産設備を有する会社ではなく、どの部門においてもあくまで人の考え、その際の人中心の業務を推進している。アイデア中心に進めている会社である。

資本政策・株主還元の基本方針については、基本的な考え方として、「企業価値向上」「連結ROE10%」をベースに念頭におき持続的改善を図っていききたい。そして、積極的かつ継続安定的な利益還元の考えでから連結配当性向30%を中期的目標においている。そして、持続的成長のため、研究開発に連結売上高の10%を投資している。

株主構成について

当社の株主構成(所有株主数ベース)は、個人株主が約1/3、金融機関(機関投資家)も約1/3、外国人株主は2割を超えている。長期保有株主も多く、今後そういった株主を増やしていきたい。国内機関投資家は、著名で長期保有の投資家に所有していただいている。他には日本の個人投資家になじみの多い投資家にも保有していただいている。

株主還元について

株主還元は、基本的な考え方として「中期的に配当性向30%」を念頭においている。直近3年では、2018年12月期 28%、2019年12月期 39.9%、2020年12月期 30.9%だった。2021年12月期は30.4%で想定している。また、自己株式取得や株主優待も実施している。

MECの今後について

当社が成長するキーワードは「5G」「IoT・AI」「クルマ」である。「5G」は通信方式の世代で、今後「5G」「6G」と進んでいく。このように進むにつれ情報量と通信量が指数関数的に増えていく。いよいよ本格的に5Gが立ち上がり、ここに当社薬品を適用していく。今後パッケージ基板も大型化の流れにある。「IoT・AI」は5Gと共に大量の情報処理を必要とする分野であり、エッジコンピューティングを含めいろいろな所にAIが搭載されていく。情報通信量が非常に多くなり、それを処理するための半導体が増えていく流れである。「クルマ」も、自動運転はネットワークにつながり、通信情報系、制御系の半導体が増えていく流れになる。電気自動車はモーターと電池のコントロールが非常に重要になる。

5Gの特徴は「高速大容量」「低遅延」「多接続」である。高速で伝えられ低遅延である。もう一つは、たくさんの機器を同時に接続することができる。今後アプリケーションがどんどん増えていくのではないかと期待している。

コンピューターは、CPUとそれを記憶するメモリーこの間の距離をいかに短くするかが性能を上げることに非常に重要になっている。今後、更なる性能向上を図るためパッケージ基板は進化し、大変付加価値が高いものとなる。

クルマには多くの半導体が多様な用途で使われている。一台当たり50から100個使われていて、情報通信の需要が増えていく中で、当社技術も求められている。そこを深掘りし、その進化そして世の中の進化を支えていきたい。

電子基板製造関連分野向け薬品の他に、ディスプレイ関連分野向けにも、従来から力を入れていて、さらに力を入れていきたい分野である。樹脂金属接合関連分野向けは実績としては少ないが、大変重要なアプリケーションをとるに至っている。

新たな成長ステージのキーワードは「5G」「IoT」「AI」「クルマ」。それをつなぐ「インターネット」「サーバー」「ストレージ」。これらは全て半導体が使われている。当社技術でそこに貢献していく。そして社会インフラの発展を支えるとともに、当社の成長を実現していきたい。

株主様へのメッセージ

当社製品（薬品）をとおり社会インフラの発展に貢献しながら、業績をしっかりと伸ばしていきたい。応援よろしく申し上げます。

質疑応答

回答者：メック株式会社 代表取締役社長 前田和夫

質問1. コロナの影響具体的に説明してほしい。

回答1. 一年少し前に最初に中国武漢で発生し、昨年2、3月あたりには中国ではロックダウンがあり経済活動が停止するような大変な状況であった。当社も中国蘇州と珠海に工場があり、その影響を受け、ロックダウン期間大変な苦勞をしたが、その間もなんとか業務を動かしていた。当社が重要なインフラに組み込まれているということであり、業務を継続しなければならなかった。そういった中、最初は落ち込んでいた中国国内におけるビジネスも徐々に回復し、4、5月にはかなり忙しくなってきた。その後はずっと忙しい状況が続いている。当社グループの業績への影響は、巣ごもりの影響で、PCやタブレット端末が世界的にかなり売れ、それをつなぐネットワークの需要でサーバーやストレージ等これらも半導体をたくさん使うので、結果的に当社売上に対し追い風になった。一方、経費は海外出張ができなかった状況もあり、あまりかからなかった。

質問2. 米中貿易摩擦の影響は。

回答2. 基本的には大きなビジネスの流れは止めづらいのではないかと思う。アメリカは、自国に製造業を回帰させるという動きになっており、中国も自国内への投資に舵を切った。双方ともに活発に投資活動しているという意味においては、チャンスと捉える。

質問3. 半導体不足と言われていますが業績への影響は。

回答3. 需要面と供給面で話すと、供給面では、もともと半導体不足は、コロナの影響による巣ごもり需要や情報通信系が忙しくなったこともあって、自動車向けが品薄になっていた。そこに、アメリカでの大寒波の影響で生産がかなり滞った。さらに日本で大手半導体メーカーの火災があり、続けて問題が起こっている。自動車はもともと半導体が不足していたところに、こういった問題が重なった。自動車向けの半導体が少なくなっていたのは、情報通信系が非常に伸びているからだ。5G関連のネットワークのためのサーバー等に投資をしようとする、必要な半導体のその性能演算機能、メモリー機能は指数関数的に増え、そこに対する投資がすごく大きく、それに対する生産が非常に増えている。供給側はそういう状態である。とにかく需要が増えている状態であり、当社にとっては、得意としている情報通信系、特に当社の先端技術を使ってもらえる分野が伸びているので、結果的には忙しい方向に向かっている状況である。

質問 4. 半導体メーカー各社が大規模な投資を行っているその影響は。

回答 4. 当社は半導体の後工程で使われるパッケージング技術のための付加価値の高い高密度な基板製造に深くかかわっている。半導体の投資が増えると後工程が増え、高密度な基板も増える。私どものお客さまの仕事が増え、お客様がまた投資をする。そこに当社薬品の使用量が増えていく流れになる。実際活発になってきている。

質問 5. メックの類似企業として「JCU」「太陽 HD」にも注目している。彼らは基板事業以外にも積極的に進出しているが、メックはどうか。

回答 5. これらの会社様は相当異なる分野をやっていると思っている。当社も離れたところに興味がないわけではない、当社は、基板以外に新しい領域を見つけようとずっと努力してきた。基本的には、できれば近い分野でも柱をしっかり立てていきたい。つまり、当社製品は半導体後工程に多く使われているので、そこをもう少し深掘りする。半導体そのものにももう少し近づくとすることで何か開拓していきたいと探索している。後は、ディスプレイも引き続き探索中である。今、当社技術が必要でなくても、成熟してくると当社のような生産性を向上できる製品が必要になるタイミングがある。それを逃さないよう近い分野をしっかり探索するような活動をしている。それにかかわらず分野が遠くてもいろんなものを物色している。

質問 6. AI が広く普及した場合、メックの優位性や社会へ貢献できるポイントはあるか。また現段階で AI の活用状況、活用を検討している業務があれば教えてほしい。

回答 6. 二つの側面から話す。一つの側面は、工業用薬品を供給する立場としての AI。例えばデータセンターに AI がたくさん組み込まれるところがある。いろいろな機器がそこにつながり、そこにおけるそのエッジコンピューティングにも AI が搭載されてくる状況になる。結果、そこで演算し解析してメモリーに貯めて送ってまたメモリーに貯めて演算して…こういうことがいろいろな場所で発生し、情報通信量が非常に増えることになる。AI が増える、社会に浸透することはつまり、そのための半導体が増える。そのために当社の薬液も要求レベルが上がり量も増えるといった流れになると考えている。もう一つの側面は、AI を使う側の立場。例えば、研究開発に活かせる技術。AI には「識別するタイプ」「予測するタイプ」「会話をするタイプ」「何か物事を実行するタイプ」といった用途がある。特に当社の研究開発で使えるのは、「画像識別」「各種予測」といった技術。研究開発の促進にもつながる。その他にも、工場における良品の認定等にも使うことができると考えている。AI にはかなりしっかりと取り組んでいかなければならない。

質問7. 2021年12月期（当期）業績予想について、売上は7.1%伸びる一方で、営業利益が5.5%の増益でそれほど伸びる予想になっていない理由は。

回答7. 2020年12月期（前期）はコロナの影響でかなり特殊な環境だった。需要は今後も続いていくと感じている。前期は経費が非常に軽く例年の収益構造とは異なった。また、2020年12月期までは設備投資を続け、今、人財強化を考えている。それらを踏まえ今回の利益計画である。

質問8. 3年、5年後の成長シナリオを教えてください。

回答8. 当社は半導体関連という伸びる分野に入っていて、これは今現在も非常に需要が高まっている。5Gが本格的に立ち上がってくると、それに対応してネットワークの充実、つまり、サーバーやストレージの需要が高まる。物量は増え、その中身も高品質、最先端に向かっている。両方のベクトルがあり、当社はその発展を支える役割も果たしていく。

そういう流れの中で、結果として業績がついてくると考えている。まず、半導体分野で社会ニーズに応じて社会インフラを充実させ、当社のポジションを社会的に認めていただいて伸びていくという流れを描いている。6Gが2030年といわれていて、“山”“谷”はあるかもしれないが、向こう10年は基本的な流れとしてあると思う。当社はしっかりそれに応える。3年後は、まず今のコア事業を確実に伸ばしていくことが一番重要。もう一つは、今小規模ながら研究開発レベルで探索中のものの中からはいくつか面白い「芽」が育っていればいい。これが3年後ぐらいのイメージ。5年後は、引き続きコア事業に関してはもっと発展していつている。さらに社会発展とシンクロするように大きくなっているイメージを持っている。近い分野ではより具体的な事業化が進んでいるべきであると考えている。まだ研究開発段階の“芽”は、5年後には何かしら礎になっていて、その先の戦略に重要にかかわってくるような、そういう位置にある。当社のコア事業とその芽が育って、礎になっていて重要な戦略に関わるようなものがある。何か大きな飛躍を遂げられるような、もっといろいろな所に貢献できるようなそんな会社になりかけているようなイメージを抱いている。

質問 9. 社長としての今の株価の評価と今後の株価について。

回答 9. 昨日（2021年4月2日）の株価は2,477円。株価の評価は口にしていうのは難しい。株主や投資家の皆さまの評価の結果ということで、謙虚に受け止めるべきなのだろうと考えている。株価は将来への期待というところが一番大きい。そのためには、将来、こんなことがこんな風になっていくと予見できるということが重要、業績が少しずつでもしっかり伸びていっていることが重要。そういう実行力とその成長への期待度で株価は決まると思うから、今やるべきことをきっちりやり、そして将来に向けての投資、打つべきアクションをしっかりやって、しっかり伝える。IR活動もしっかりやっていかなければならないと思っている。皆さんが当社の将来に対してワクワクするような気持ちを持っていただければいいと思う。

質問 10. こからも増配は続くのか。

回答 10. 2020年12月期年間配当金26円、当期期初見込みは、一株当たり配当金28円としている。基本的な株主還元の考え方は、連結配当性向30%を念頭においている。直近3期の実績はいずれも年間一株当たり26円の配当で、連結配当性向は2018年12月期には28%、2019年12月期は半導体不況影響で業績が落ちたため39.9%、2020年12月期は30.9%だった。当期年間配当金予想は28円で30.4%。業績を伸ばせば結果的に増配も可能な状況にあり、是非、中長期的にわたり業績伸ばすよう頑張っていく。

以 上